

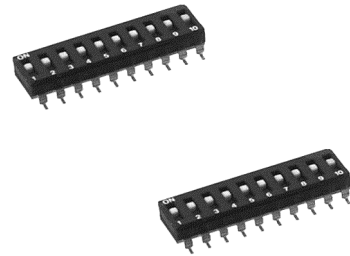
5040

SMT DIP-Schalter - Standard Version

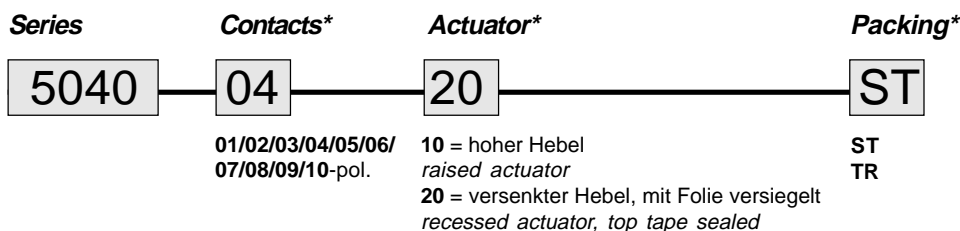
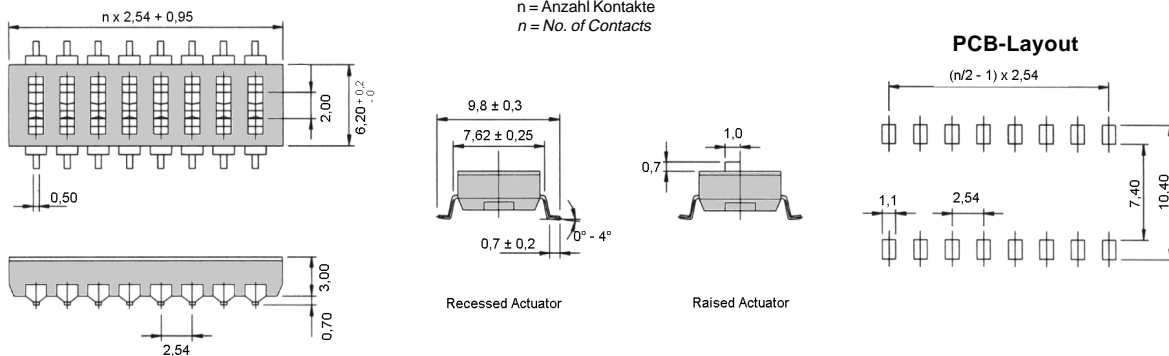
SMT DIP-Switch - Standard Version

Technische Daten / Technical Data:

Gehäuse/Abdeckung/Hebel <i>Case/Cover/Actuator</i>	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94V0 <i>Thermoplastic, rated UL94V0</i>
Farbe <i>Colour</i>	schwarz <i>black</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Phosphorbronze, vergoldet über Nickel <i>Phosphor Bronze, gold plated over nickel</i>
Kontaktbelastbarkeit	50 V _{DC} 100 mA in Ruhe 24 V _{DC} 24 mA im Schaltzustand 50 V _{DC} 100 mA at steady situation 24 V _{DC} 24 mA at mate and break
Contact Rating	
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	≤ 50 mOhm im Auslieferungszustand ≤ 50 mOhm at initial
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 10 ⁸ Ohm bei 500 V _{DC} > 10 ⁸ Ohm at 500 V _{DC}
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	500 V _{AC} , 1 min. 500 V _{AC} , 1 min.
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-20°C...+85°C -20°C...+85°C
Mechanische Lebensdauer <i>Mechanical Life</i>	min. 2000 Schaltungen/Schalter min. 2000 operations/switch
Elektrische Lebensdauer <i>Electrical Life</i>	min. 2000 Schaltungen/Schalter min. 2000 operations/switch
Verarbeitung <i>Processing</i>	Reflow-Lötverfahren; weitere Informationen in Kapitel T Reflow-Soldering, further informations in chapter T



© W+P PRODUCTS



Lieferformen / Packing Options:

ST = verpackt in Stangen / packed in tubes
TR = Tape & Reel Verpackung / Tape & Reel Packing

(* Bestellbeispiel - Bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* Order example - To be replaced by your specifications.)

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow-Soldering Informations

Reflow-Lötverfahren Reflow-Soldering

Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflowverfahren verarbeitet werden (Maximalwerte):

Profil Eigenschaft	Bleifreies Löten
Durchschnitts-Ramp-Up Rate ($T_{s_{max}}$ to T_p)	3 °C / Sek. Max.
Vorheizen - Temperatur Min ($T_{s_{min}}$) - Temperatur Max ($T_{s_{max}}$) - Zeit ($t_{s_{min}}$ auf $t_{s_{max}}$)	150°C 200°C 60-180 Sekunden
Verbleiben oberhalb: - Temperatur (T_L) - Zeit (t_L)	217°C 60-150 Sekunden
Peak/Klassifizierung Temperatur (T_p)	260°C +/- 5°C
Zeit innerhalb von 5°C um die Peak-Temperatur (t_p)	20-40 Sekunden
Ramp-Down Rate	6°C / Sekunde max.
Zeit von 25°C bis zur Peak-Temperatur	8 Minuten max.

© W+P PRODUCTS

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature-profile for leadfree reflow-soldering (maximum values):

Profile Feature	PB-Free assembly
Average Ramp-Up Rate ($T_{s_{max}}$ to T_p)	3 °C / second max.
Preheat - Temperature Min ($T_{s_{min}}$) - Temperature Max ($T_{s_{max}}$) - Time ($t_{s_{min}}$ to $t_{s_{max}}$)	150°C 200°C 60-180 seconds
Time maintained above: - Temperature (T_L) - Time (t_L)	217°C 60-150 seconds
Peak/Classification Temperature (T_p)	260°C +/- 5°C
Time within 5°C of actual Peak Temperature (t_p)	20-40 seconds
Ramp-Down Rate	6°C / second max.
Time 25°C to Peak Temperature	8 minutes max.

Empfohlenes Reflow-Lötprofil:

Recommended Reflow-Soldering profile:



T